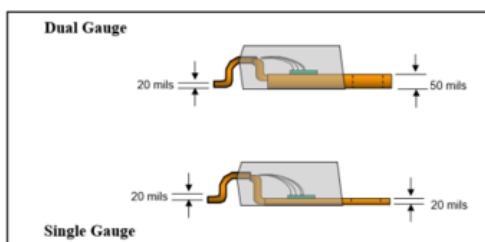




Title of Change:	The change is to improve product package robustness by changing of ICD2PAK 5LD from dual gauge to single gauge frame, change leadframe material from KFC material to HCL-12S, add in mold lock on the heatsink and change mold compound from G600 to G700HF.
Proposed Changed Material First Ship Date:	04 Feb 2022 or earlier if approved by customer
Current Material Last Order Date:	N/A <i>Orders received after the Current Material Last Order Date expiration are to be considered as orders for new changed material as described in this PCN. Orders for current (unchanged) material after this date will be per mutual agreement and current material inventory availability.</i>
Current Material Last Delivery Date:	N/A <i>The Current Material Last Delivery Date may be subject to change based on build and depletion of the current (unchanged) material inventory</i>
Product Category:	Active components – Integrated circuits
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or AhmadFaris.Dzulkipli@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office to place sample order or <PCN.samples@onsemi.com> . Sample requests are to be submitted no later than 45 days after publication of this change notification. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Sample Availability Date:	N/A
PPAP Availability Date:	N/A
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or MohdHairwan.MdNor@onsemi.com
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. The change will be implemented at 'Proposed Change Material First Ship Date' in compliance to J-STD-46 or ZVEI, or earlier upon customer approval, or per our signed agreements. ON Semiconductor will consider this proposed change and it's conditions acceptable, unless an inquiry is made in writing within 45 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com .
Change Category	
Category	Type of Change
Process - Assembly	Change in leadframe dimensions, Change of encapsulation/sealing material

Description and Purpose:

To notify customers of the change in leadframe material from KFC to HCL-12S, package thicknesss from 50mils to 20mils, add in mold lock design on heatsink and change mold compound from G600 to G700HF. The change is to improve product package robustness.





	Before Change Description	After Change Description
LeadFrame	Material: KFC Thickness: Dual Gauges (50mils) Heatsink: No mold lock	Material: HCL-12S Thickness: Single Gauge (20mils) Heatsink: mold lock
Mold Compound	G600	G700HF

There is no product marking change as a result of this change

Reason / Motivation for Change:	Process/Materials Change
Anticipated impact on fit, form, function, reliability, product safety or manufacturability:	The device has been qualified and validated based on the same Product Specification. The device has successfully passed the qualification tests. Potential impacts can be identified, but due to testing performed by ON Semiconductor in relation to the PCN, associated risks are verified and excluded. No anticipated impacts.
Sites Affected:	
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	None
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Date Code, Lead frame thickness, Mold lock design

Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME: NCV87722D5S33G (Analog, LDO Regulator)

RMS : S55722, S57752

PACKAGE: D2PAK 5LD

Test	Specification	Condition	Interval	Result
HAST	JESD22 A110	130°C/85% RH , ~18.8 psig	192 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150 °C	2016 hrs	0/231
HTOL	JESD22 A108	TA=125°C	1008 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -65°C to +150°C	500 cyc	0/231
UHASt	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 245 °C		0/693
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/45

NOTE: AEC-1pager is attached.

To view attachments:

1. Download pdf copy of the PCN to your computer
2. Open the downloaded pdf copy of the PCN
3. Click on the paper clip icon available on the menu provided in the left/bottom portion of the screen to reveal the Attachment field
4. Then click on the attached file

**Electrical Characteristics Summary:**

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Current Part Number	New Part Number	Qualification Vehicle
NCV4275ADS33R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4275ADS50R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4275ADS50R4G-IR01	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4275CDS33R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV8675DS50R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4290DS50R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4276CDSADJR4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4276CDS50R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4276CDS33R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4276BDSADJR4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4276BDS50R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4276BDS33R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4275CDS50R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

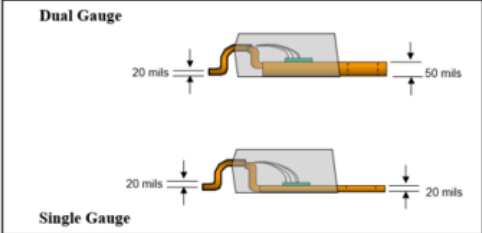
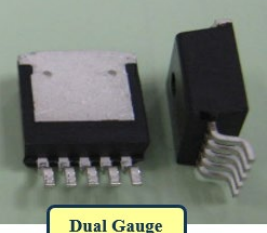
注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号 : FPCN23071Z

発行日 : 04 Aug 2021

変更件名:	この変更は、ICD2PAK 5LD のデュアル ゲージからシングル ゲージ フレームへの変更、リードフレームの素材の KFC 素材から HCL-12S への変更、ヒートシンクのモールド ロックの追加、モールド コンパウンドの G600 から G700HF への変更により、製品パッケージの堅牢性を向上させるためのものです。
初回出荷予定日:	2022 年 2 月 4 日 または、お客様に承認された場合はそれ以前
現在の材料の最終注文日:	N/A 既存品の最終注文日以降の注文は、この PCN に記載されている変更後品の注文とみなされます。この日付より後の既存品(変更前品)の注文は、相互契約により変更前品の在庫状況に応じて履行されます。
現在の材料の最終出荷日:	N/A 既存品(変更前品)の最終出荷日は、変更前品の製造および在庫の状況によって変更されることがあります。
製品カテゴリ:	アクティブなコンポーネント – 集積回路
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < AhmadFaris.Dzulkipli@onsemi.com > にお問い合わせください。
サンプル:	サンプルの注文または < PCN.samples@onsemi.com > を注文するには、お近くの ON Semiconductor 営業所にお問い合わせください。 サンプルのリクエストは、この変更通知の公開後 45 日以内に提出してください。 サンプルの納品時期は、リクエスト日、サンプル数量、特別なお客様の梱包/ラベルの要件に従います。
サンプル提供開始可能日:	N/A
PPAP 提供開始日:	N/A
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または < MohdHairwan.MdNor@onsemi.com > にお問い合わせください。
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。 この変更は、「変更後の材料の初回出荷予定日」に J-STD-46 または ZVEI に準拠して実施されるか、お客様からの承認が得られた場合はそれ以前に、あるいは署名された契約書ごとく実施されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 45 日以内に書面による問い合わせが行われない限り、この変更案およびその条件が受諾されたものとみなします。お問い合わせは、 PCN.Support@onsemi.com をお願いします。
変更カテゴリ:	
カテゴリ	変更種別
処理 – アセンブリ	リードフレーム寸法の変更, 封入材料/封止材料の変更
説明および目的:	
リードフレームの素材の KFC から HCL-12S への変更、パッケージの厚みの 50 ミルから 20 ミルの変更、ヒートシンクのモールド ロックの設計の追加、モールド コンパウンドの G600 から G700HF への変更をお客様に通知するため。この変更は、製品パッケージの堅牢性を向上させるためのものです。	
  	



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23071Z

発行日: 04 Aug 2021

	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	素材: KFC 厚み: デュアル ゲージ (50 ミル) ヒートシンク: モールド ロックなし	素材: HCL-12S 厚み: シングル ゲージ (20 ミル) ヒートシンク: モールド ロック
モールド・コンパウンド	G600	G700HF

今回の変更に伴う製品表示の変更はありません。

変更の理由 / 動機:	処理/材料の変更
適合性、形状、機能、信頼性、製品安全性、または製造可能性に関して見込まれる影響	デバイスは同じ製品仕様に基づいて認定および検証されています。デバイスは認定試験に正常に合格しています。潜在的な影響が確認される可能性があります。オン・セミコンダクターが PCN に関して実施する検査により、関連するリスクは検証され排除されています。 予想される影響はありません。

影響を受ける拠点:

オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / サブコン拠点:
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	無し

部品の表示 / 変更の追跡可能性:	データコード、リードフレームの厚み、モールド ロックの設計
-------------------	-------------------------------

信頼性データの要約:

デバイス名: NCV87722D5S33G (Analog, LDO Regulator)

RMS: S55722, S57752

パッケージ: D2PAK 5LD

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HAST	JESD22 A110	130°C/85% RH, ~18.8 psig	192 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150 °C	2016 hrs	0/231
HTOL	JESD22 A108	TA=125°C	1008 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -65°C to +150°C	500 cyc	0/231
UHASt	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 245 °C		0/693
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/45

注: AEC-1 ページが添付されています。

添付文書を見るには:

1. ご使用のコンピューターに PDF 版の PCN をダウンロードします。
2. ダウンロードした PDF 版の PCN を開きます。
3. 添付欄を見るには、画面左 / 下部分のメニュー 上にあるクリップアイコンをクリックしてください。
4. 添付ファイルをクリックします



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23071Z

発行日: 04 Aug 2021

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 標準の部品番号 (既製品) のみが部品一覧に記載されます。本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メールの顧客の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

現在の部品番号	新部品番号	認定試験用ピークル
NCV4275ADS33R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4275ADS50R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4275ADS50R4G-IR01	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4275CDS33R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV8675DS50R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4290DS50R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4276CDSADJR4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4276CDS50R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4276CDS33R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4276BDSADJR4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4276BDS50R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4276BDS33R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G
NCV4275CDS50R4G	N/A	NCV87722D5S33R4G